

1MM-R-D19-VS-00-H-TBP ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU Small Centerline

TE 内部编号 1-2267440-9

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 38 Position, 1 mm [.039 in] Centerline, Gold, Surface Mount, Signal, Black, AMPMODU Small Centerline

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 38

行数: 2

中心线 (间距) : 1 mm [.039 in]

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

施加的压力	低
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端

结构特性

板对板配置	平行
装载位置数量	38
可堆叠	否
连接器端子负载状态	满载
信号位置数量	38
位数	38
行数	2
PCB 安装方向	垂直

电气特征



端接电阻	16 mΩ
介质耐压（最大值）	1000 VAC
工作电压	30 VAC

主体特性

装配过程特性材料	不锈钢
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子接触部长度	2 mm
端子保护类型	闭合入口壳体
接合方柱尺寸	.3 mm[.011 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子布局	直插式
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.00076 μm[30 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	SMT 引线, 矩形
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.1 mm[.003 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.24 mm[.009 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	底部和顶部
--------	-------



外壳材料	LCP
------	-----

中心线 (间距)	1 mm [.039 in]
----------	----------------

尺寸

连接器长度	19.6 mm
-------	---------

连接器高度	3.12 mm
-------	---------

PCB 厚度 (建议)	.8 – 1.6 mm [.031 – .063 in]
-------------	------------------------------

行间距	1 mm
-----	------

使用环境

壳体温度额定值	高
---------	---

工组温度范围	-55 – 125 °C
--------	--------------

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖, 拾放盖
--------	----------

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | AMPMODU Small Centerline



客户还购买了





文档

产品图纸

[SCL 1.0 RCPT DR VT 038 SMT G3 TBK](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2267440-9_10.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2267440-9_10.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2267440-9_10.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU 1.0 mm CENTERLINE INTERCONNECTION SYSTEMS](#)

英文版本

[Datasheet - AMPMODU Small Centerline](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本